

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2010年8月号

● 特集

p.73 左↓3行目：主な構成材料の役割と特徴は図2(c)の通りです。←この文章を削除

p.116 右↓2行目：約 $+4.300 \times 10^{-6}/K$ →約 $+4300 \times 10^{-6}/K$

p.136 右↑5行目： C_1 や C_2 → C_{x1} や C_{x2}

p.137 図7のキャプション： C_1 と C_2 → C_{x1} と C_{x2}

p.137 図7： $C_1 = C_2$ → $C_{x1} = C_{x2}$

p.141 右↓8行目：相転位温度→相転移温度

p.148 右↓19行目：Gカーブ→右から2本目のカーブ

p.149 右↓3行目：温度特性図のAカーブが→温度特性図は

● 2.4 GHzBPF

p.185 右↓3行目：図2(a)に示します。→図3(a)に示します。

p.185 右↑8行目：周波数に上限が→素子値に上限が

p.187 図B(a)左側： N^2N_2 → N^2Z_2

p.188 左↓5行目：コラム2の→コラム1の

p.189 図4のキャプション：図2の→図3の

p.189 図4のキャプション：図2(f)の→図3(f)の

● オブザーバ制御

p.197 右↓1行目：参考文献7→参考文献6

p.198 右↑8行目：参考文献3→参考文献4